附件1：

第三届BEYOND国际科技创新博览会

参会参展申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展出地点：澳门金光国际会展中心 | | | | | | 展出时间：2023年5月10-13日 | | |
| 单位名称（中文） | | |  | | | | | |
| 参展单位名称（英文） | | |  | | | | | |
| 单位地址（中文） | | |  | | | | | |
| 单位地址（英文） | | |  | | | | | |
| 联系人 | | |  | 电话1 |  | | 电话2 |  |
| 电子邮件 | | |  | 传真 |  | | 手机 |  |
| 是否为中国中小企业国际合作协会会员？ 是，请注明会员级别  否 | | | | | | | | |
| 参与方式 参会 标展 个（9㎡/个） 特展 ㎡（36㎡起订） BEYOND Awards 大奖 | | | | | | | | |
| 申请展位方向 生命科学 可持续发展 消费科技 | | | | | | | | |
| 生命科学 | | 生物技术 医学技术和设备 生物制药 诊断与平台 | | | | | | |
| 可持续发展 | | 城市可持续发展 生态可持续发展 | | | | | | |
| 消费科技 | | 个人科技 居家科技 出行科技 | | | | | | |
| 主 要 展 品 | 中文（不超过200字）： | | | | | | | |
| 英文（不超过200字）： | | | | | | | |
| 报名截至日期：**2023年 03 月 31 日**，发至邮箱15652625982@163.com，协会审核后将逐一进行对接。 | | | | | | | | |
| 我单位同意上述信息填写真实有效，如是参展企业，同意上述参展条款并保证参展的图片、信息的合法性，保证其不存在任何知识产权纠纷问题，保证所有提交材料的真实、准确、合法。 | | | | | | | | |